

平成23年3月期(第9期) 決算説明会

平成23年5月18日
株式会社ジーダット

平成23年3月期のポイント

**前年同期比:売上高 Δ 5%、経常利益 Δ 37%、
当期利益 Δ 39%**

3年連続減収減益

固定費 Δ 8%、経常利益率2.6%

研究開発投資 Δ 13%、売上高比率27%

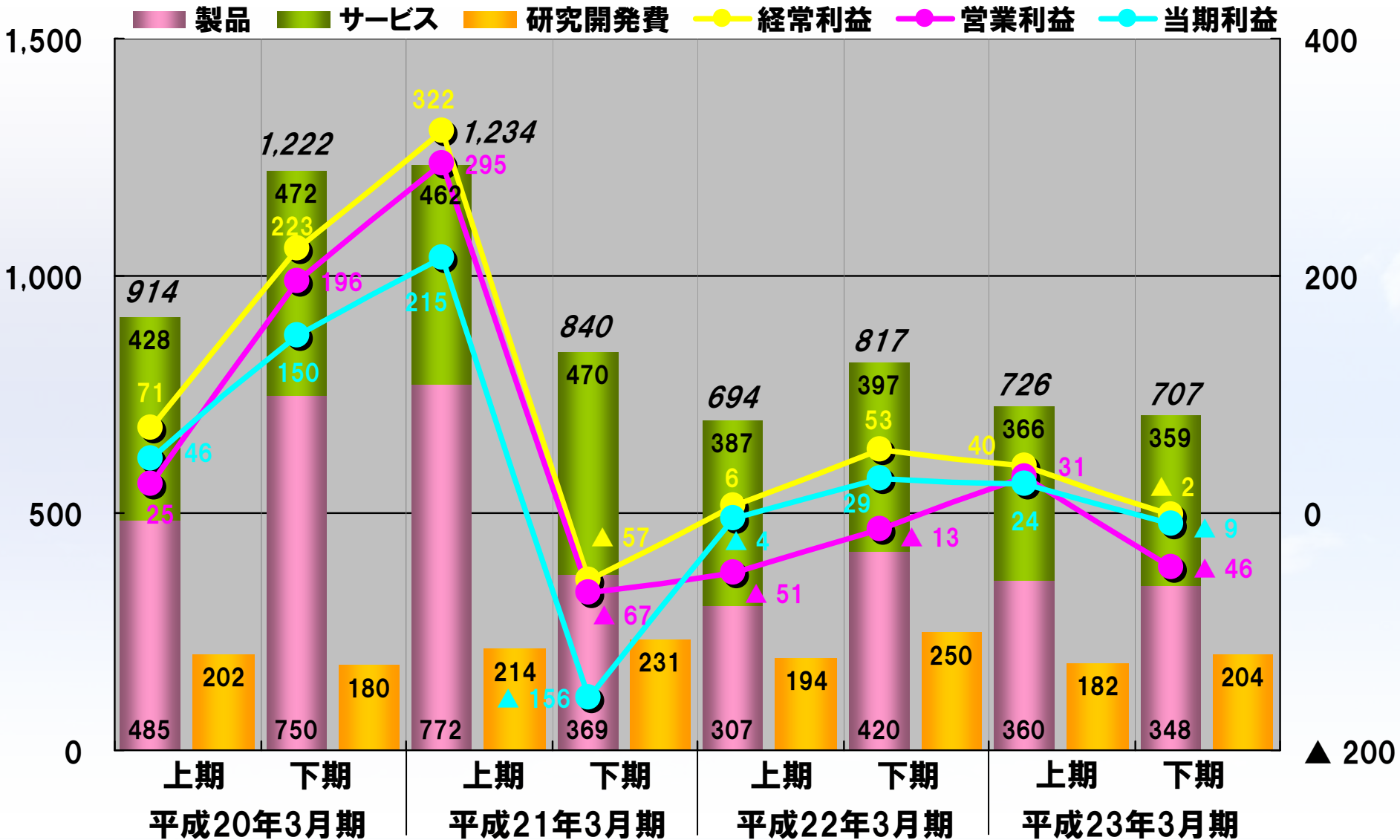
平成23年3月期業績概要(連結)

(単位：百万円)

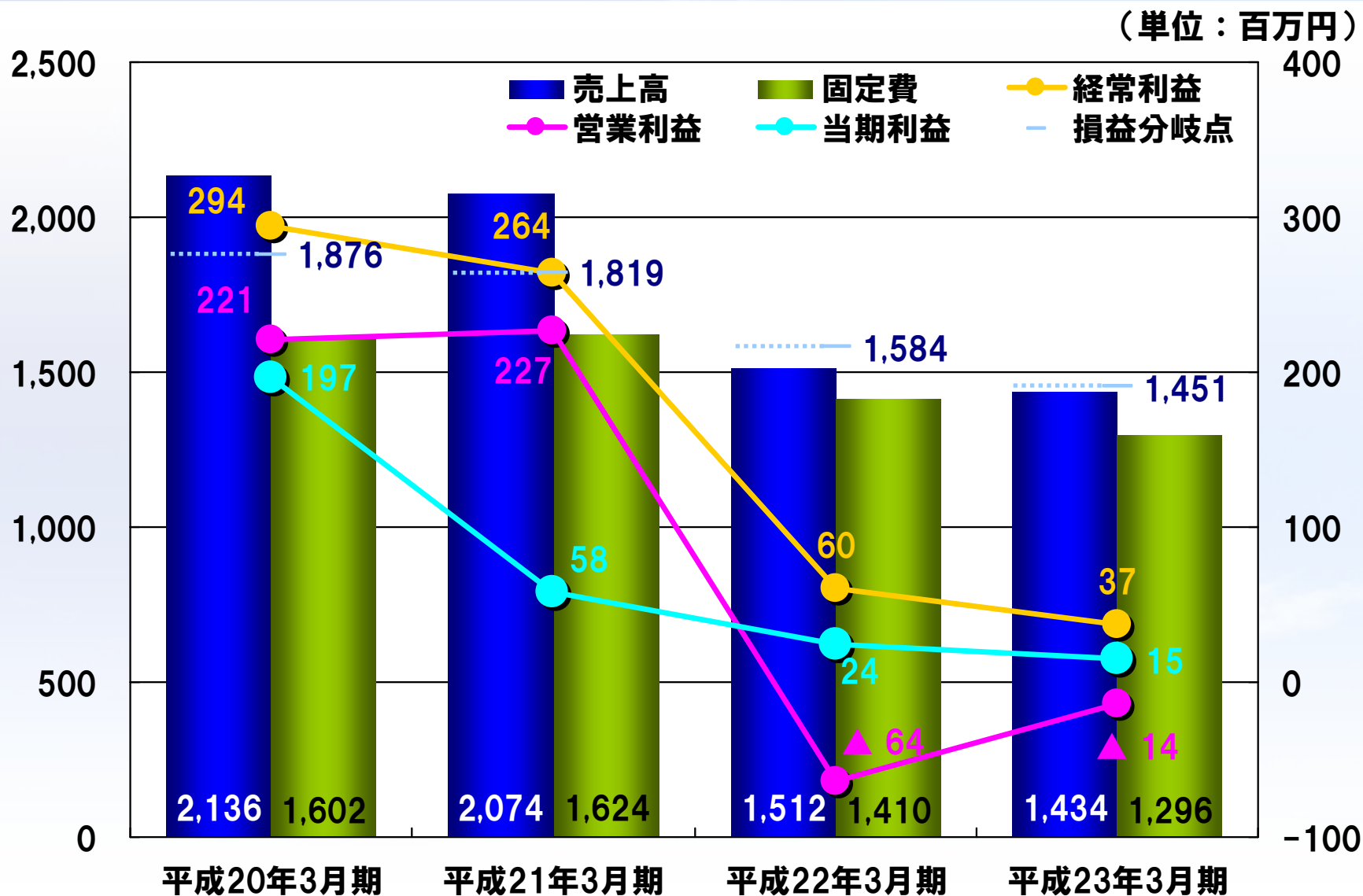
	平成22年3月期		平成23年3月期 計画		平成23年3月期		
	実績	売上高比	修正計画	売上高比	実績	売上高比	対前年 同期比
売上高	1,512	100.0%	1,425	100.0%	1,434	100.0%	△5.1%
売上総利益	1,025	67.8%	990	69.5%	1,006	70.1%	△1.9%
販売費及び 一般管理費	1,089	72.1%	1,008	70.8%	1,021	71.2%	△6.3%
営業利益	△64	△4.3%	△17	△1.2%	△14	△1.0%	—
経常利益	60	4.0%	33	2.3%	37	2.6%	△37.3%
当期純利益	24	1.6%	16	1.2%	15	1.1%	△38.5%

半期毎売上高・利益の推移

(単位：百万円)



売上・利益の推移

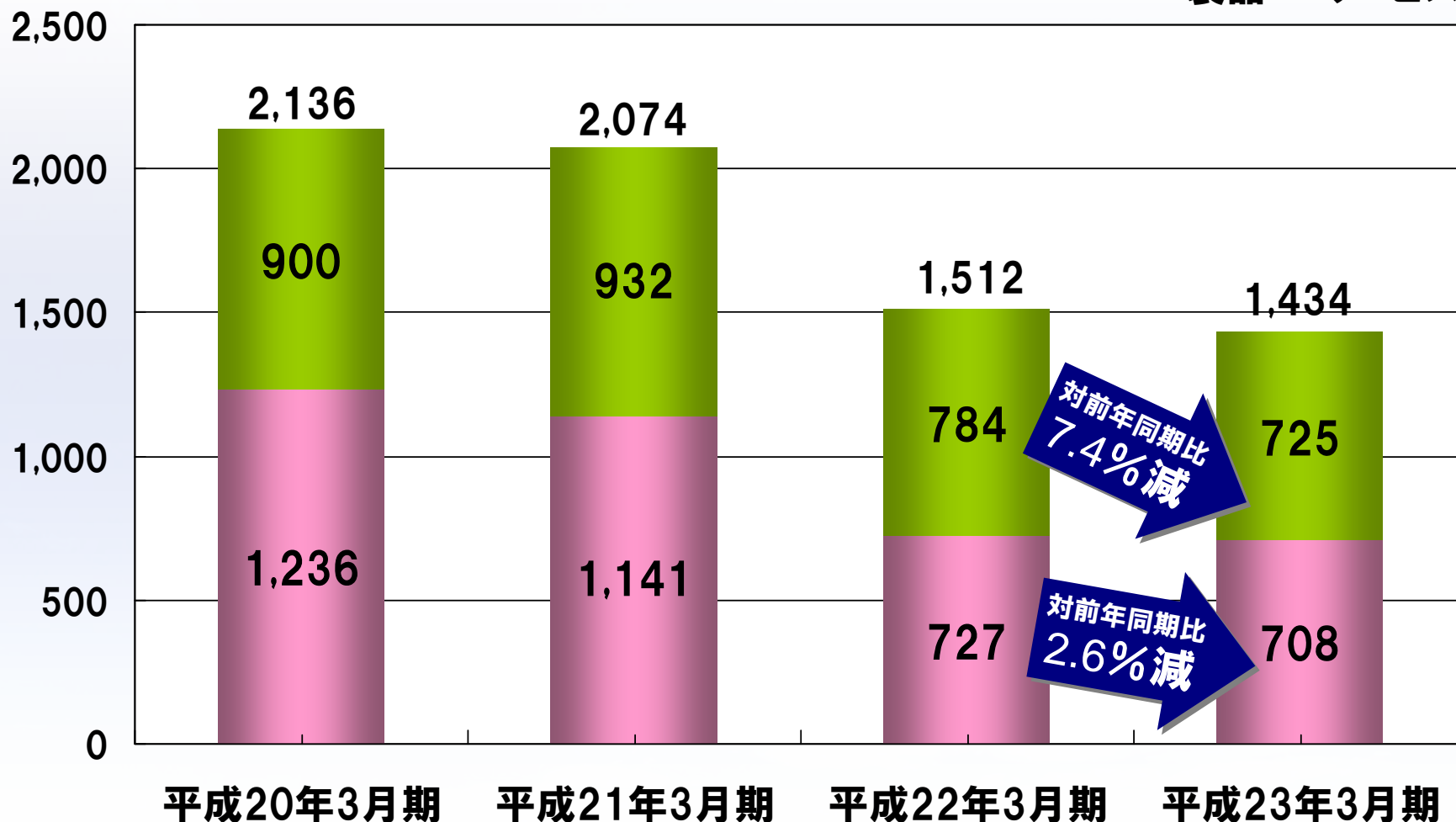


事業別売上高の推移

【製品／サービス】

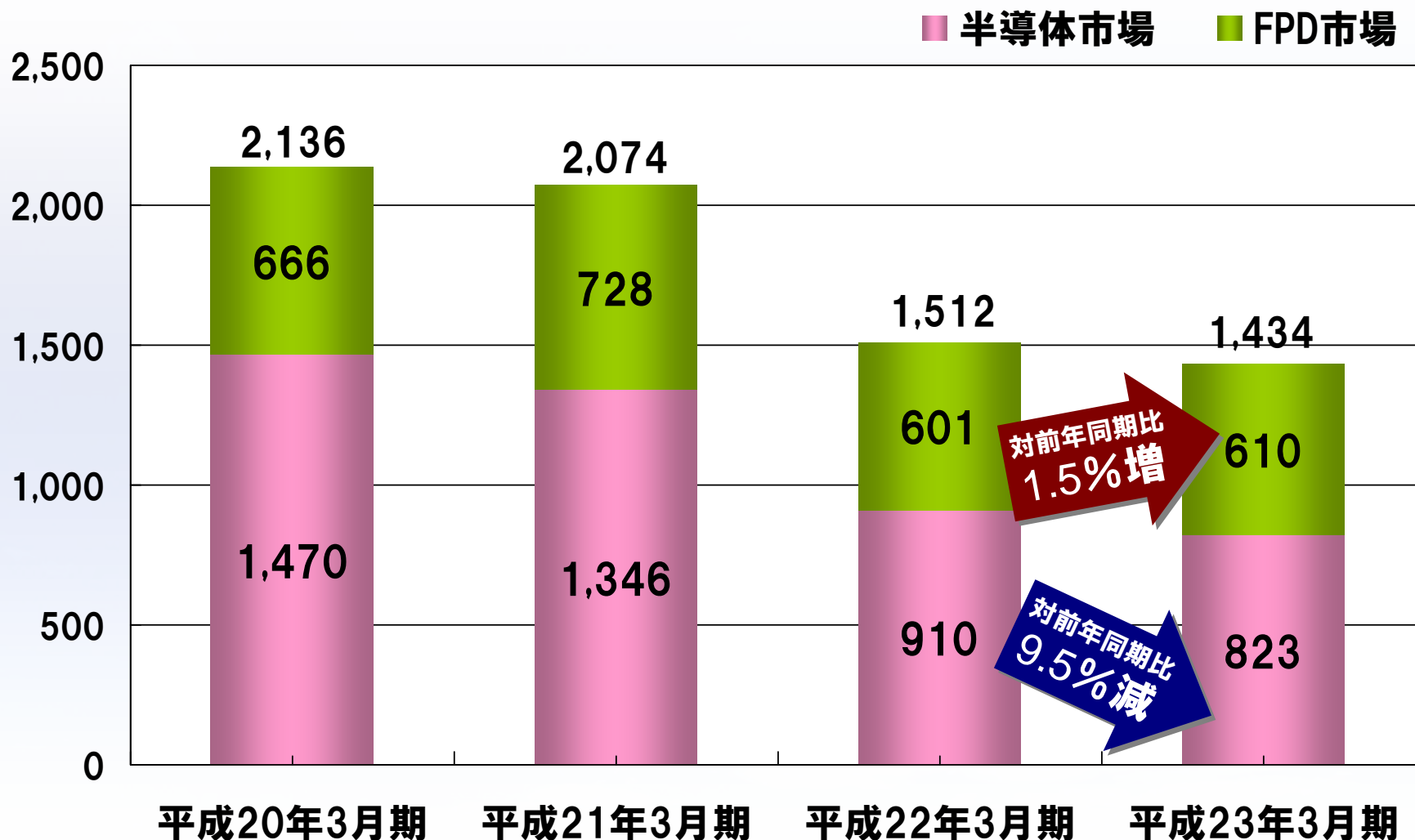
(単位：百万円)

■ 製品 ■ サービス



【半導体市場／FPD市場】

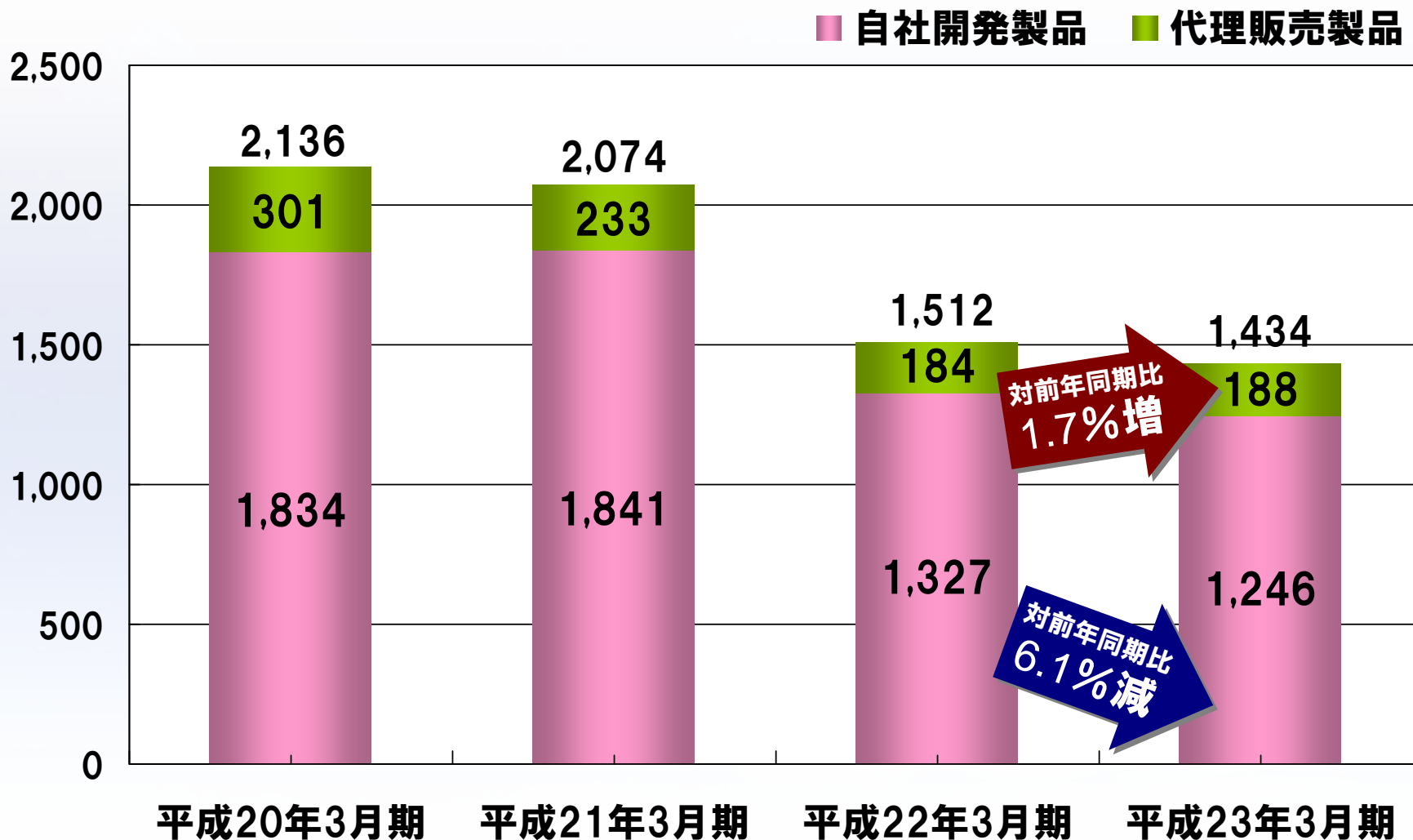
(単位：百万円)



製品区分別売上高の推移

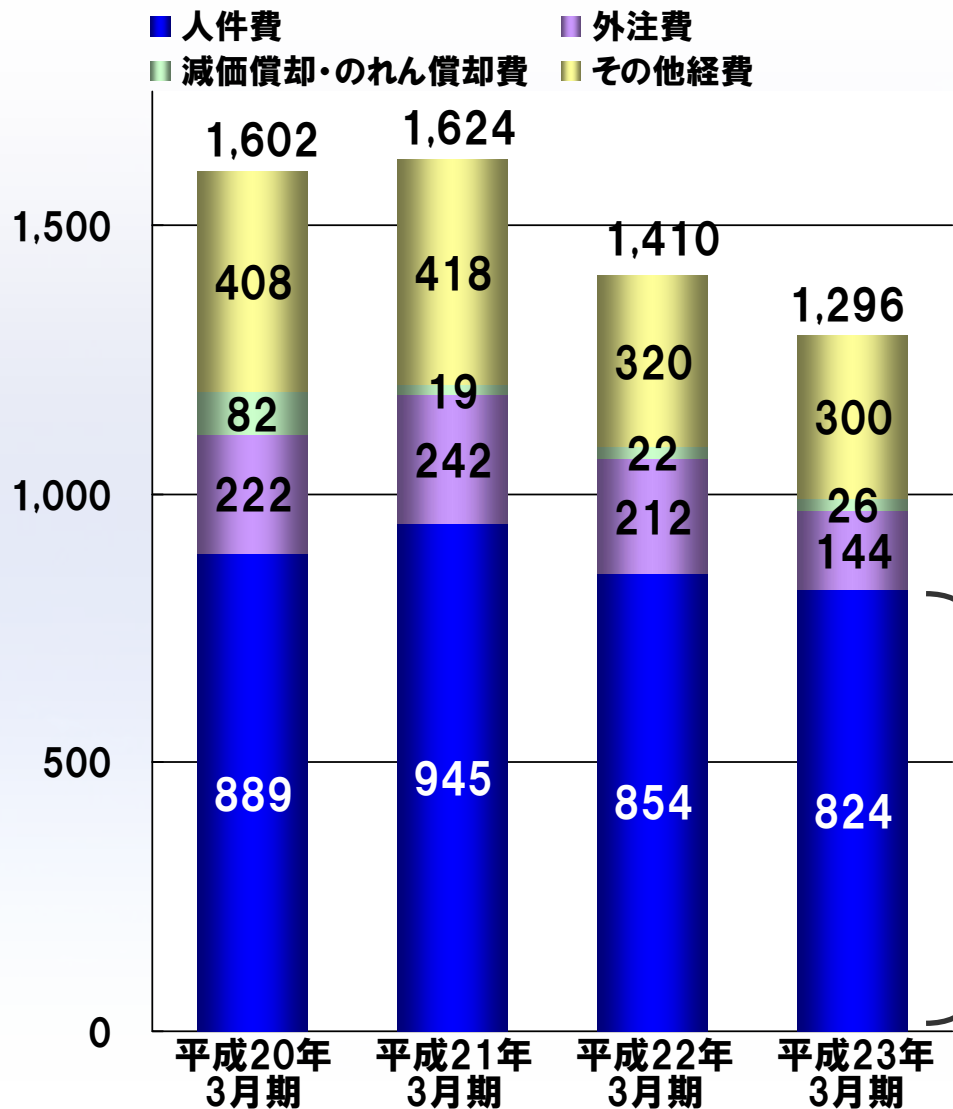
【自社開発製品／代理販売製品】

(単位：百万円)



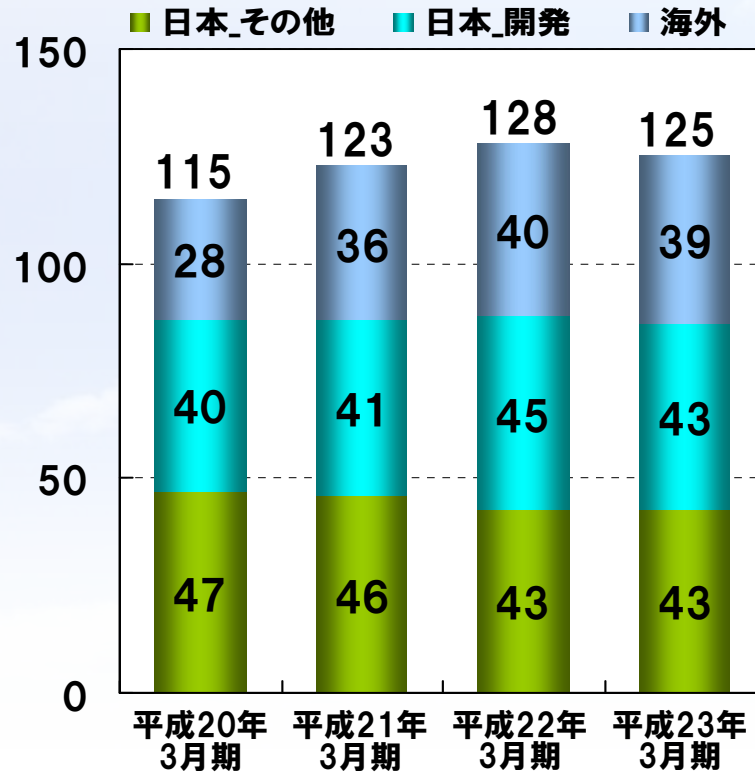
固定費内訳

(単位:百万円)

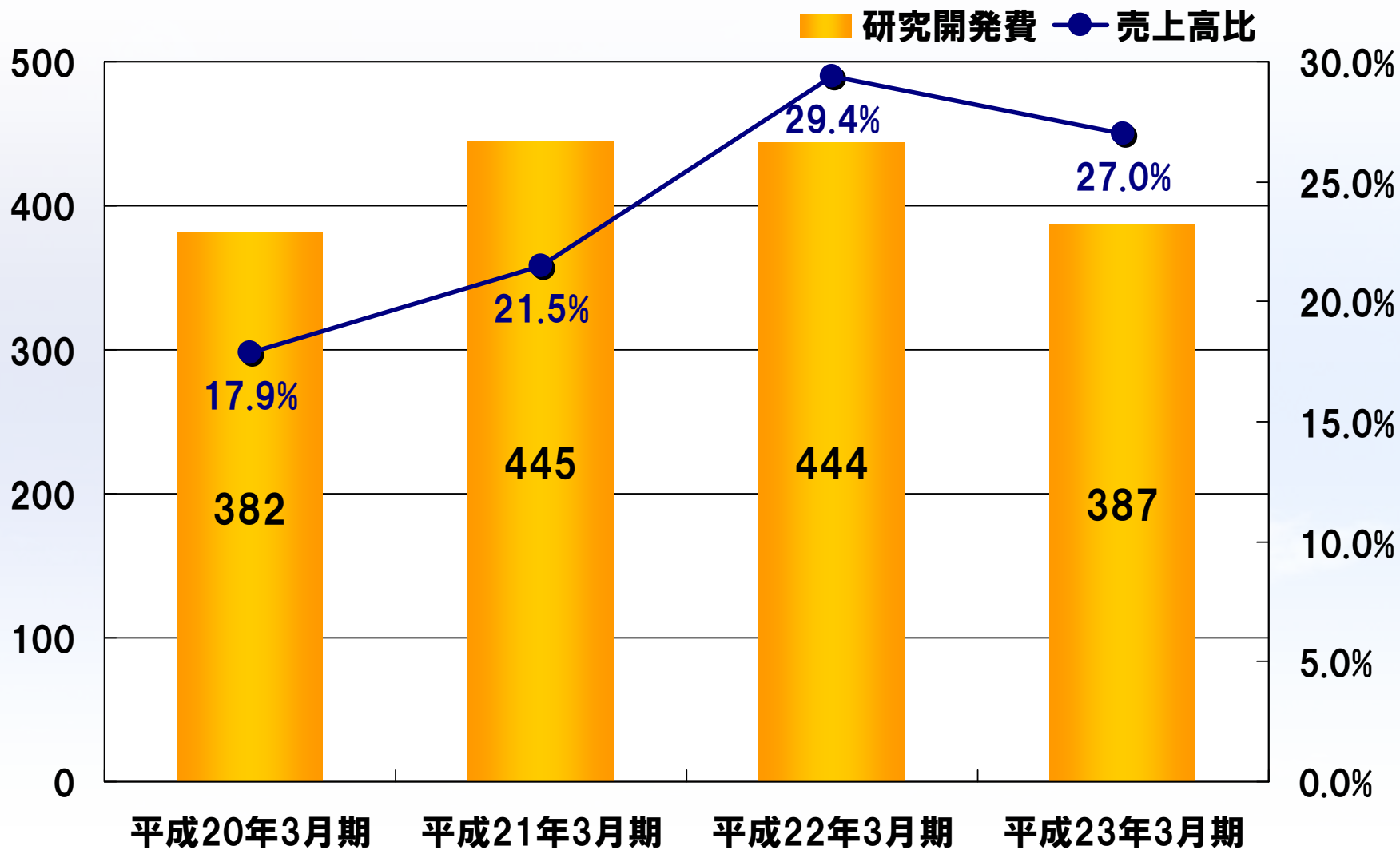


【期末社員数】

(単位:人)



(単位：百万円)



連結貸借対照表

(単位：百万円)

	平成22年 3月期末	平成23年 3月期末	差異		平成22年 3月期末	平成23年 3月期末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,070	2,353	283	I 流動負債	248	224	△23
1 現金及び預金	1,681	2,054	372	1 買掛金	48	34	△14
2 受取手形及び売掛金	291	214	△76	2 未払法人税等	6	8	2
3 たな卸資産	7	7	△0	3 賞与引当金	55	40	△14
4 繰延税金資産	33	20	△12	4 その他	138	141	3
5 その他	55	56	0	負債合計	248	224	△23
II 固定資産	613	298	△314	(純資産の部)			
1 有形固定資産	35	29	△5	I 株主資本	2,435	2,432	△3
2 無形固定資産	30	22	△8	1 資本金	760	760	—
3 投資その他の資産合計	547	246	△300	2 資本剰余金	890	890	—
長期貸付金	1	0	△1	3 利益剰余金	818	814	△3
繰延税金資産	196	193	△2	4 自己株式	△32	△32	—
長期預金	300	0	△300	II 評価・換算差額等	△1	△4	△3
その他	49	53	3	その他有価証券評価差額金	—	—	—
				為替換算調整勘定	△1	△4	△3
				純資産合計	2,434	2,427	△7
資産合計	2,683	2,652	△31	負債純資産合計	2,683	2,652	△31

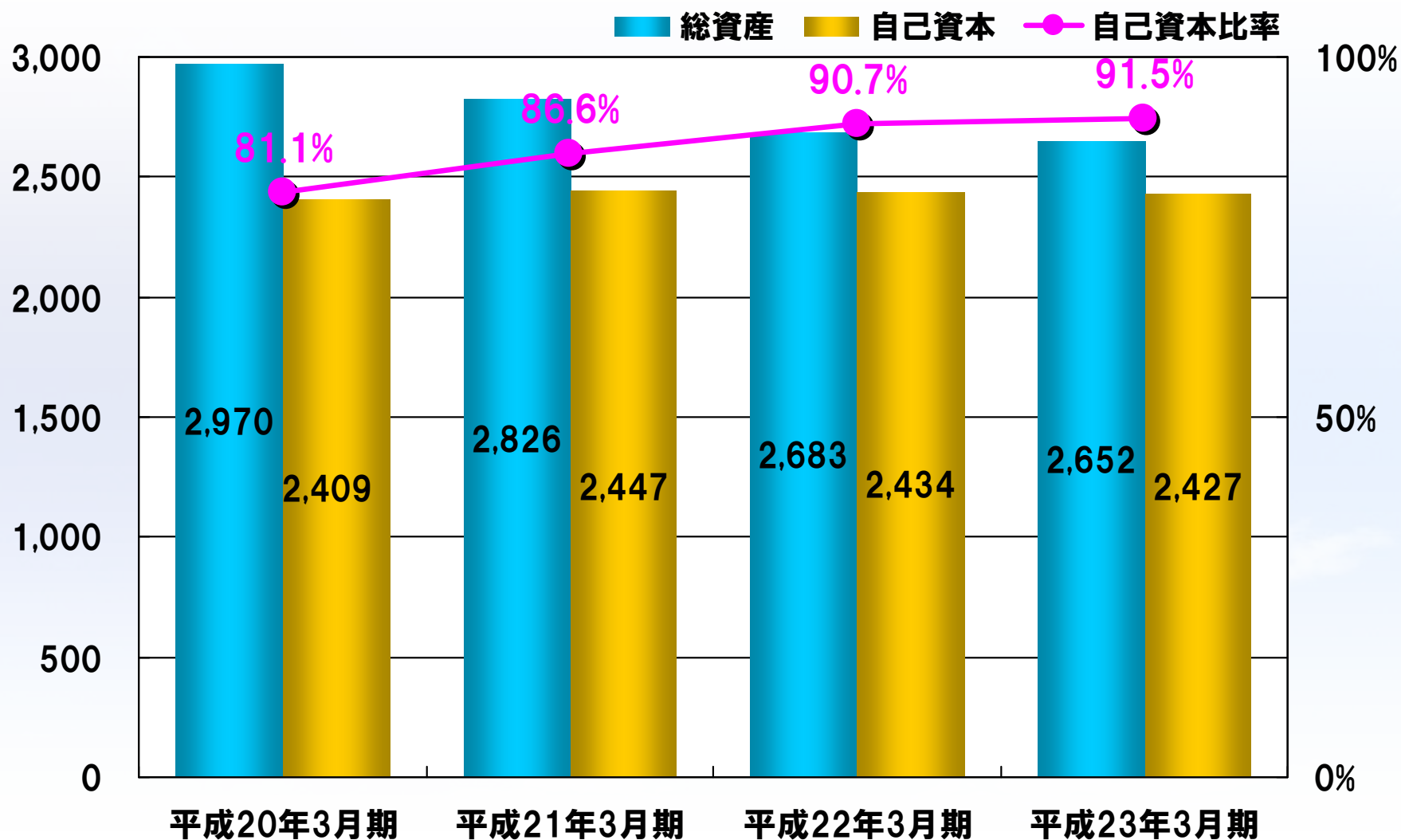
連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	平成22年 3月期末	平成23年 3月期末	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	△41	109	151
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△10	△214	△203
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△38	△19	19
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△3	△4
V 現金及び現金同等物の増減額	△89	△127	△37
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,070	981	△89
VII 現金及び現金同等物の期末残高	981	854	△127

総資産・自己資本

(単位：百万円)



3年連続売上高減少の理由は(1)

国内既存顧客の設計設備投資額の削減に対して、新規開拓および新製品売上拡大が追いついていない。

国内既存顧客の
設計設備投資
削減額
約2.4億円
(△15.9%)



新規開拓と
新製品
売上拡大
約1.6億円
(+10.6%)

この状況は東日本大震災の影響もあって今期まで続くと予想。

3年連続売上高減少の理由は(2)

<国内既存顧客の売上高減少>

- 他社競合ケースによる売上減はない
 - リーマン危機後、国内EDA市場は成熟から縮小へ
 - ✓ 国内顧客の設計者数削減
 - ライセンス数削減、サービス売上に直接影響
 - ✓ 国内顧客のEDA投資額削減
 - 大手・包括契約外予算の削減
 - 各部門ライセンスの整理・集約
- ➔ 前年比約△240百万円(製品△180、サービス△60)

3年連続売上高減少の理由は(3)

<新規開拓と新製品売上高拡大>

- 自動設計ツールの完成度向上
 - ~STARCCの当社製品認証*
 - 設計者一人当たりの生産性向上
- 検証ツールの拡充(新製品)
 - 設計段階での品質向上
 - 試作や人手検証の置換え
- 海外営業本部の設立 → 海外販売強化
- 中国R&D子会社の事業会社化 → 中国市場拡販
- ➔ 前年比約+160百万円(製品+160)

「我々の評価では、かなり高い要求目標をあげましたが、ジーダットのAmperはこの要求を唯一クリアし、完全自動化の難しいアナログ設計において、十分に実用的なツールだと思えます。

～途中省略～

これにより、ポストレイアウト全体検証までの期間を大幅に短縮することが可能になりました。」

半導体理工学研究センター（STARC）

Mixed Signal開発室長 坪井邦彦氏談

（出典：2011年1月24日（株）ジーダット プレスリリース）

平成24年3月期計画のポイント

売上高は前年度比2.4%減

研究開発投資△6%、売上高比率26%

販売戦略の見直し等により次年度以降回復へ

中国の直販体制強化

平成24年3月期業績予想(連結)

(単位：百万円)

	平成23年3月期		平成24年3月期		
	実績	売上高比	予想	売上高比	対前年同期比
売上高	1,434	100.0%	1,400	100.0%	△2.4%
売上総利益	1,006	70.1%	989	70.7%	△1.7%
販売費及び一般管理費	1,021	71.2%	1,019	72.8%	△0.2%
営業利益	△14	△1.0%	△30	△2.1%	—
経常利益	37	2.6%	20	1.4%	△47.3%
当期純利益	15	1.1%	5	0.4%	△61.0%

EDA市場・Big3の動向

EDA売上額	2007	2009	2010	対前年比
W/W	5,769M\$	4,748M\$	5,285M\$	+11%
アジア	856M\$	810M\$	1,130M\$	+40%
日本	1,176M\$	969M\$	975M\$	+6%
Synopsys	1,212M\$	1,360M\$	1,381M\$	+2%
Cadence	1,615M\$	852M\$	936M\$	+10%
Mentor	880M\$	803M\$	915M\$	+14%
JEDAT (1月-12月)	1,890M¥	1,509M¥	1,487M¥	△1%

(出典:EDA Consortium、各社Annual Report)

■ アジア市場が大幅伸張、日本市場は縮小(¥ベース)

EDA市場・Big3の動向（日本市場）

EDA売上額	2007	2009	2010	対前年比
日本市場	1,176M\$ 138,532M¥	969M\$ 90,984M¥	975M\$ 85,605M¥	+6% △6%
Synopsys	193M\$ 22,842M¥	264M\$ 24,770M¥	256M\$ 22,516M¥	△3% △9%
Cadence	339M\$ 39,952M¥	153M\$ 14,354M¥	168M\$ 14,792M¥	+10% +3%
Mentor	127M\$ 14,961M¥	120M\$ 11,264M¥	124M\$ 10,913M¥	+3% △3%
JEDAT (1月-12月)	1,890M¥	1,509M¥	1,487M¥	△1%
rate USD/JPY	117.8	93.6	87.8	

（出典：EDA Consortium、各社Annual Report）

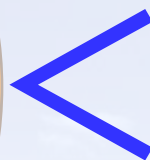
EDA市場の定性的動向

- 国内市場は、リーマンショック以降進行している設計設備投資抑制が今期も続く。
 - 但し、設計技術者減員はそろそろ底か？震災の影響が不透明
- 大震災の明確な影響として、生産設備の復興投資が優先される。
 - 設計業務については、短期的に生産工場の変更に伴う設計変更が優先されるため、新たな設計設備ニーズは弱い
 - 生産の日本離れ進行に伴う設計の日本離れは不透明
- ➔ 国内市場規模の縮小傾向は今期も続く
- FPD市場は、引き続き中国市場に比重が移っていく。
- 半導体市場は、米国のFabレスメーカーや新興国の伸びが大きい。日本は、パワー半導体、イメージセンサー、メモリを除いて厳しい。国内顧客の海外展開が進行。

次年度以降の回復へ向けて

国内販売戦略の見直し、海外販売強化により、今期を底として、新規開拓および新製品売上拡大を追求する

国内
既存顧客の
設計
設備投資
削減額



売上拡大

国内半導体既存顧客

国内半導体他社顧客

販売戦略
見直し

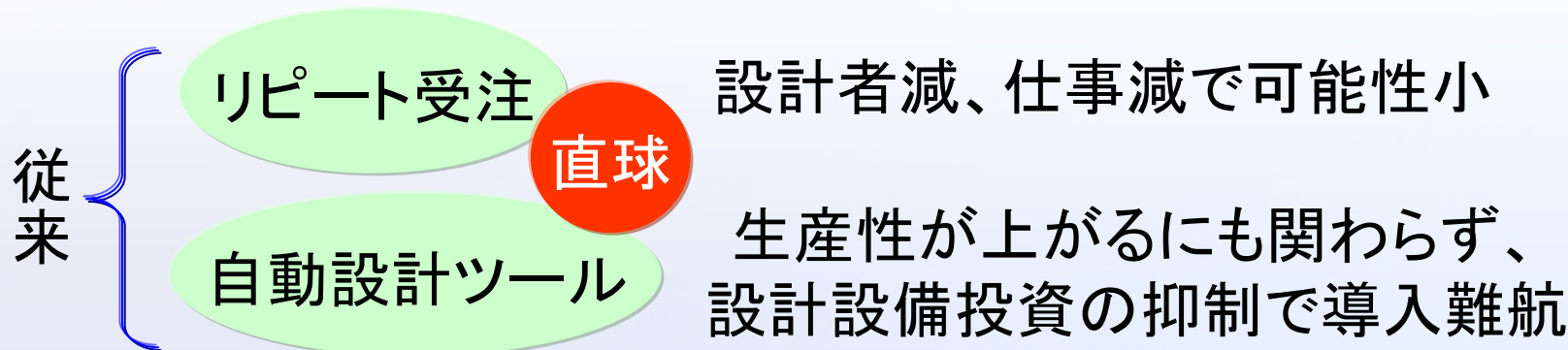
国内FPD顧客

従来戦略
継続

海外新規開拓

次ステップ

➤ 販売戦略の見直し



異なる財布、新しいニーズの掘起こし (変化球)

試作、品質保証で行われている
静電破壊検証など、実機検証を設計工程で行う
→ 技術的難易度は高いがチャレンジ！

➤ 販売戦略の見直し

従来

リプレース:

他社の設計フローを
ジエダットの設計フローに
全面的に置き換える

直球

大手・包括契約の壁の
問題のほか、
設計者減で、評価や
一時的な置換え作業の
工数捻出困難



ポイントツールの拡販:

競争力のある当社製品のI/Fを変更して、
他社フローに組み込む

変化球

競合他社のフローの強化に繋がり、ジレンマがあるが、
ハードルは低くなる。海外攻略にも有効。

アナログ関連設計総合環境

アナログ～
MixedSignalSoC



当社の施策(3) ~ 対国内FPD顧客

➤ 従来戦略の継続強化

リプレース:

他社の設計フローを
ジーダットの設計フローに
全面的に置き換える

直球

カスタマイズ:

顧客の差別化支援と
ニーズへのタイムリな対応

変化球

+

先端技術ニーズに対応した
高精度高速検証解析ツールの
タイムリな開発

豪速球

2、3年遅れで中国にも適用可能

当社の施策(4) ~ 海外FPD拡販

➤ 中国FPD市場

**直販体制
強化**

北京
開発子会社



事業会社

現在 主対象:TV
市場規模 数億円?



2,3年後
主対象:モバイル+TV
市場規模 数倍~

中国仕様製品
普及仕様・普及価格

中国仕様製品
先進仕様・普及価格

大学との連携、ツール提供、研究委託

➤ 韓国・台湾FPD市場

液晶パネル

有機ELパネル

国内と類似戦略

リプレース、カスタマイズ

先端技術ニーズ

特に重要

代理店教育
・支援強化

当社の施策(5)～海外半導体拡販

▶ 海外半導体市場

先兵

高速ビューワー
HOTSCOPE

検証機能の充実

- ・故障解析分野の拡販
- ・検査装置への組み込み

販売チャネルの拡大

現在：台湾、韓国、米国
中国直販

→ +米国、インド、欧州

主力

α-SX

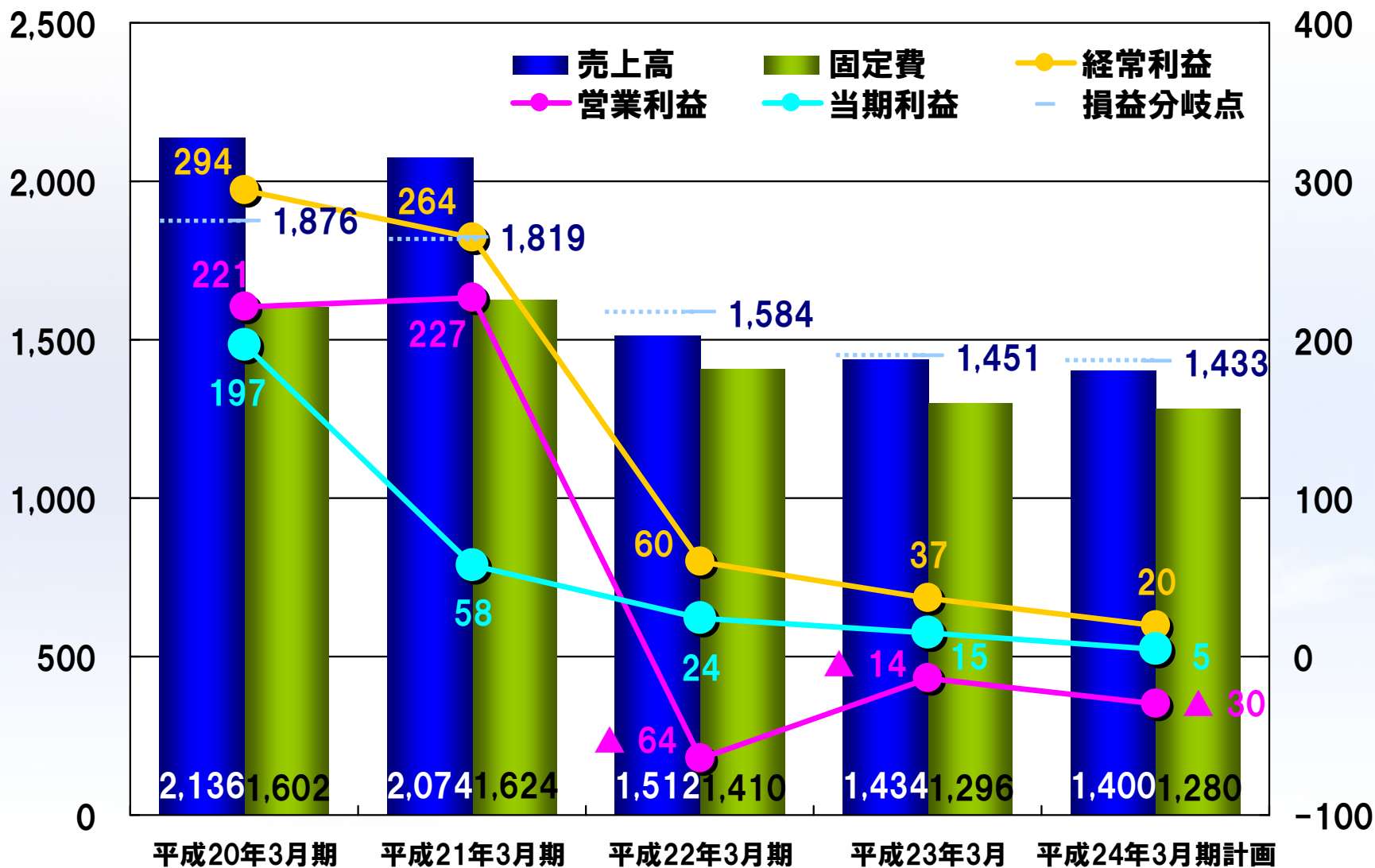
国内と類似戦略

ポイントツールの拡販：(自動系、検証系)
競争力のある当社製品のI/Fを変更して、
他社フローに組み込む→戦略製品

国内顧客の海外展開支援体制強化

売上・利益

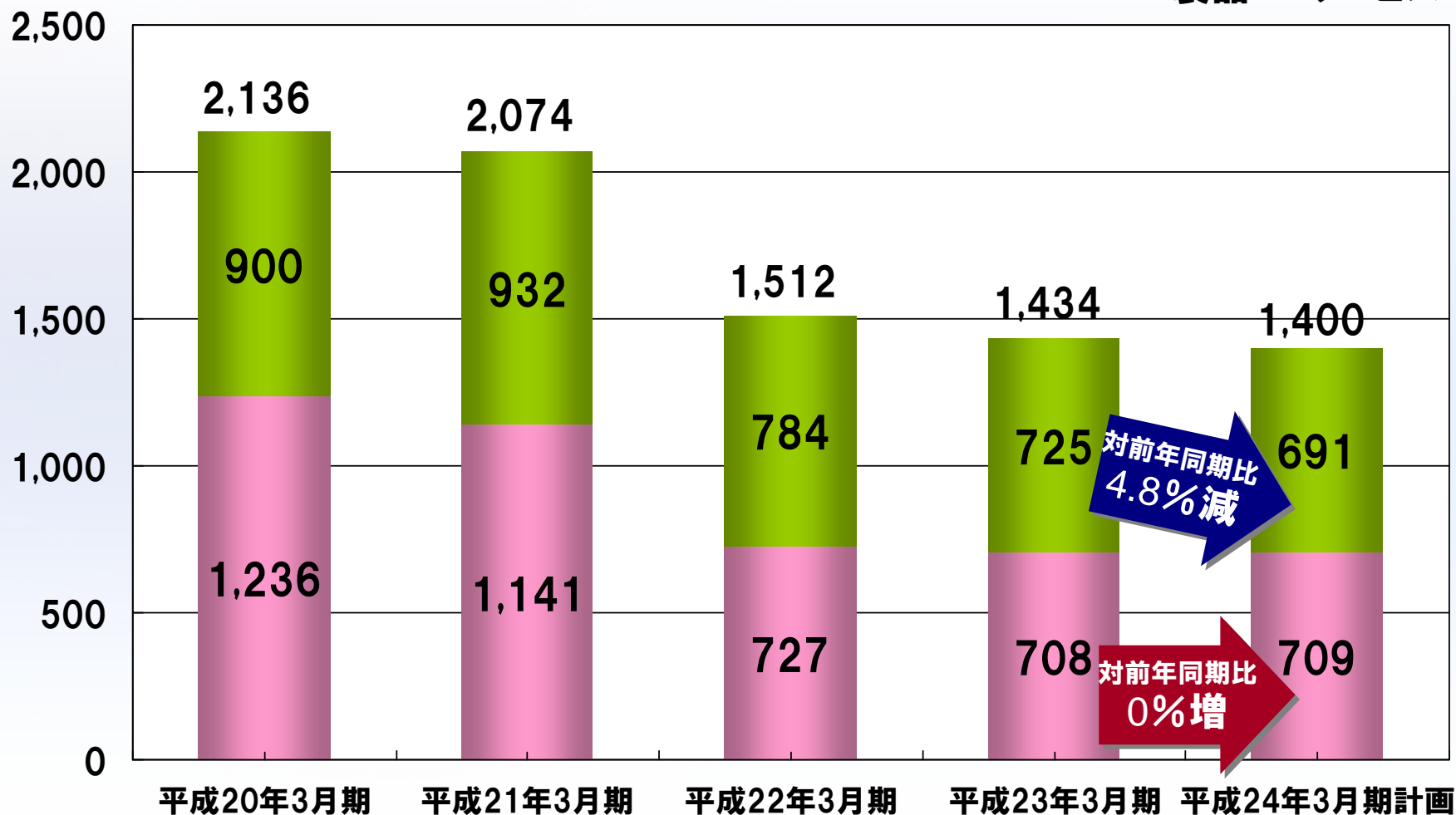
(単位：百万円)



【製品／サービス】

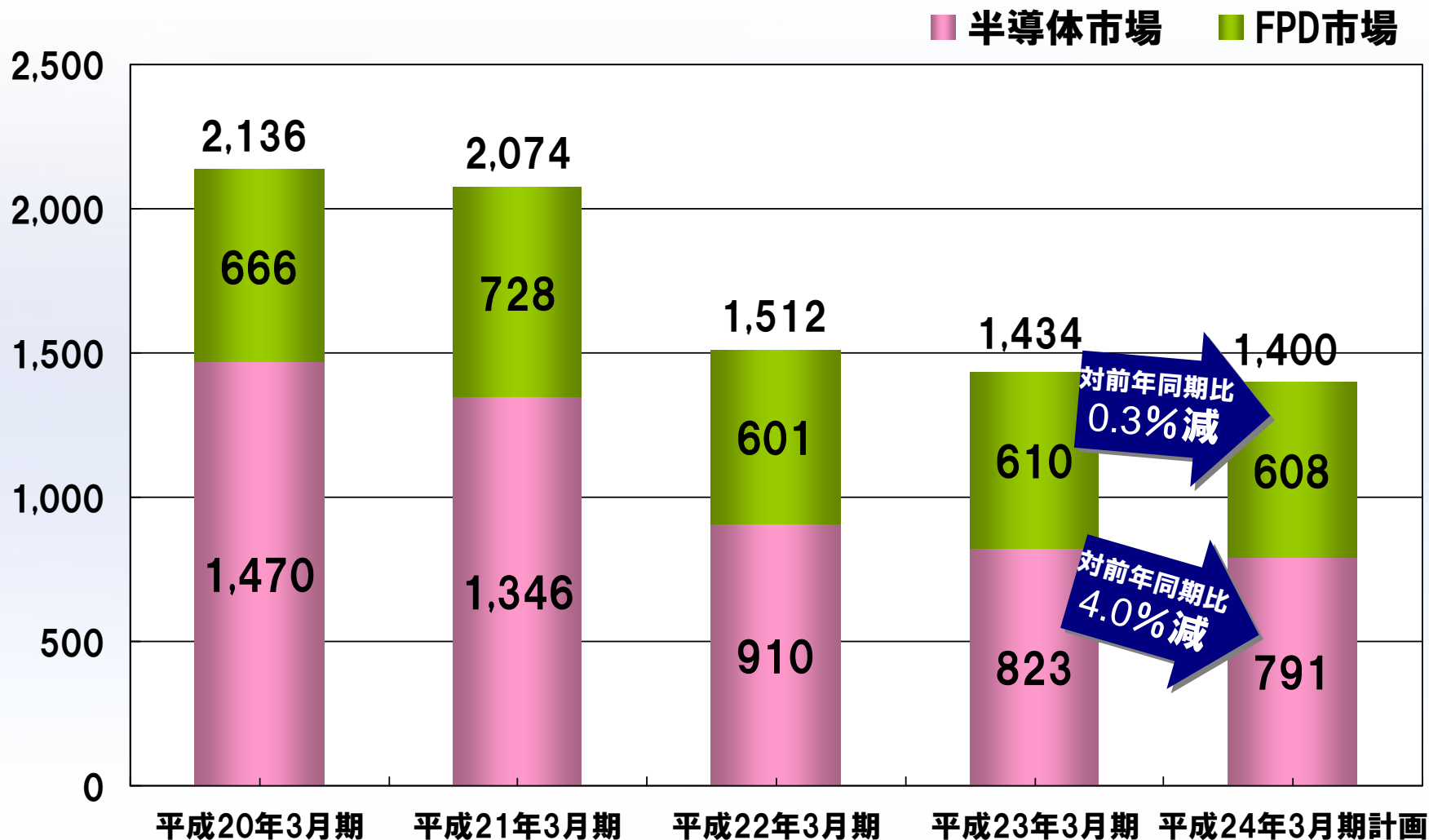
(単位：百万円)

■ 製品 ■ サービス



【半導体市場／FPD市場】

(単位：百万円)

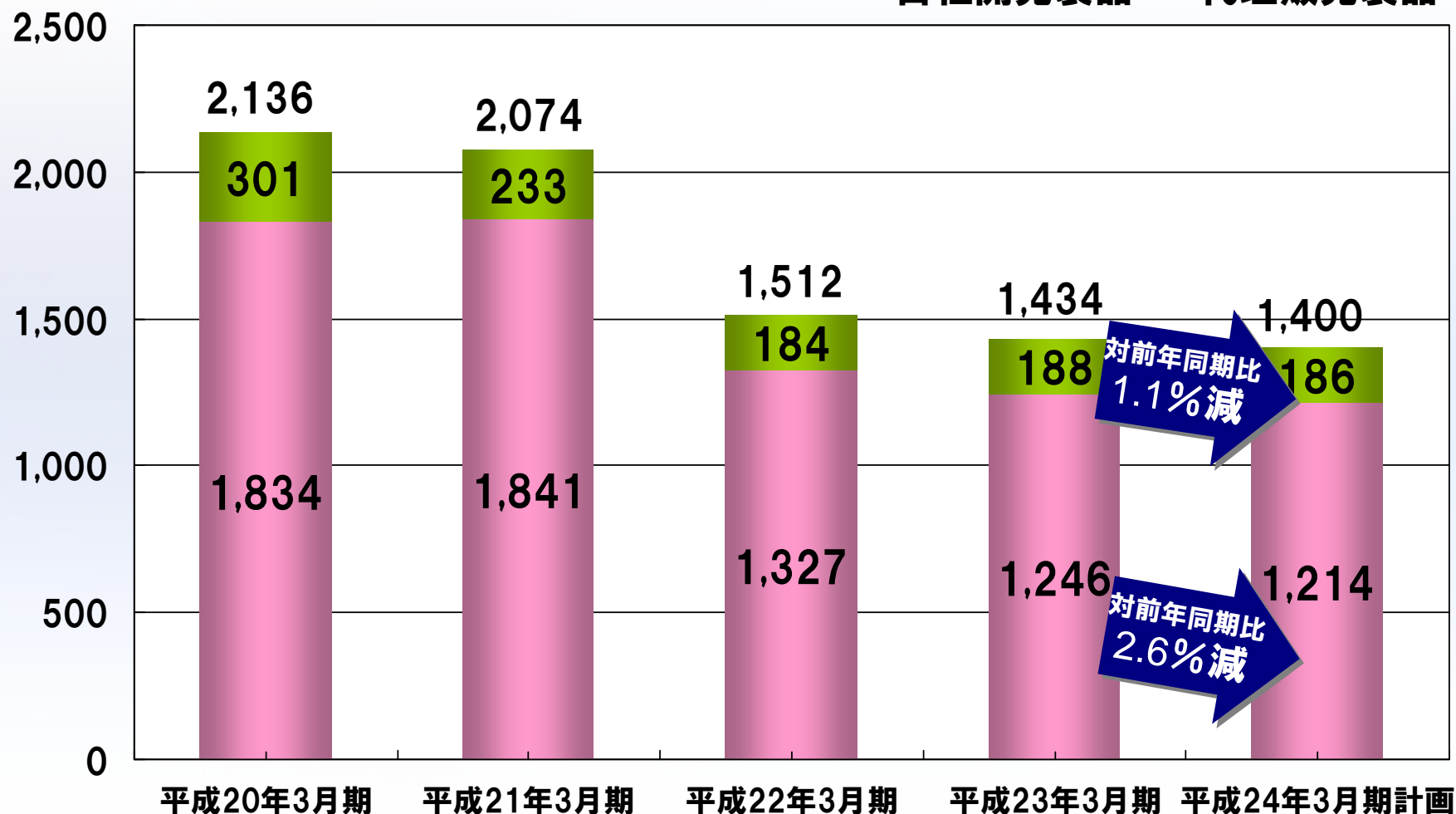


製品区分別売上高の推移

【自社開発製品／代理販売製品】

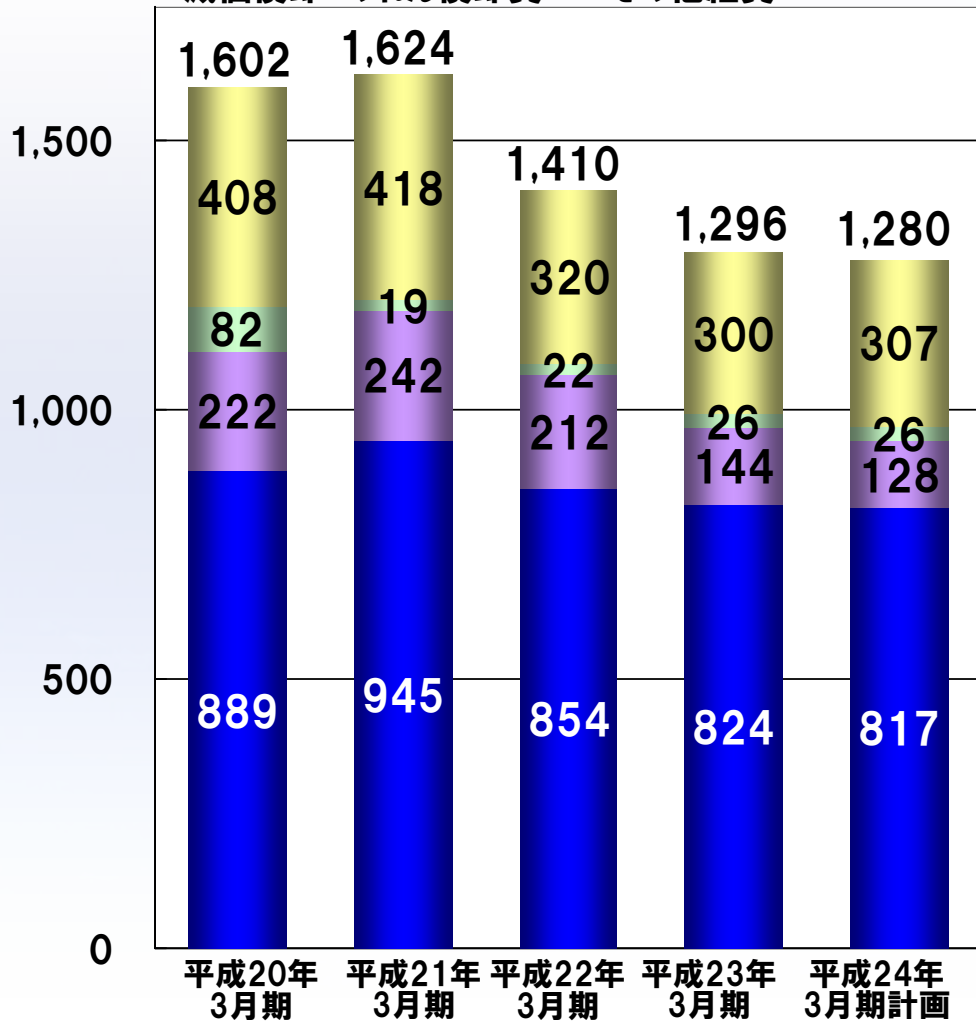
(単位：百万円)

■ 自社開発製品 ■ 代理販売製品

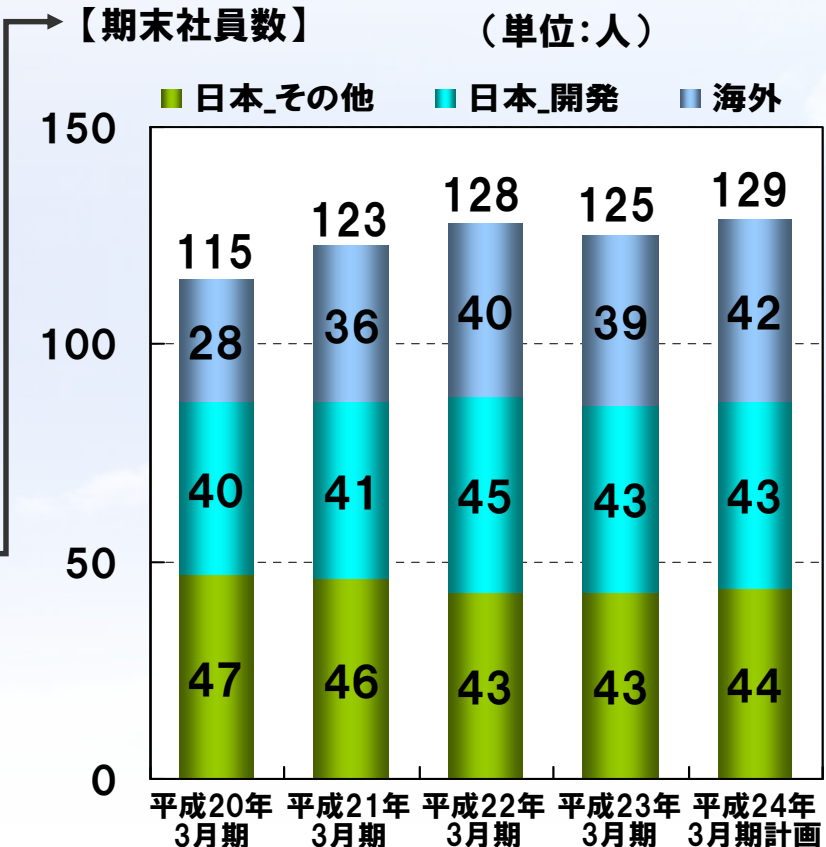


固定費内訳

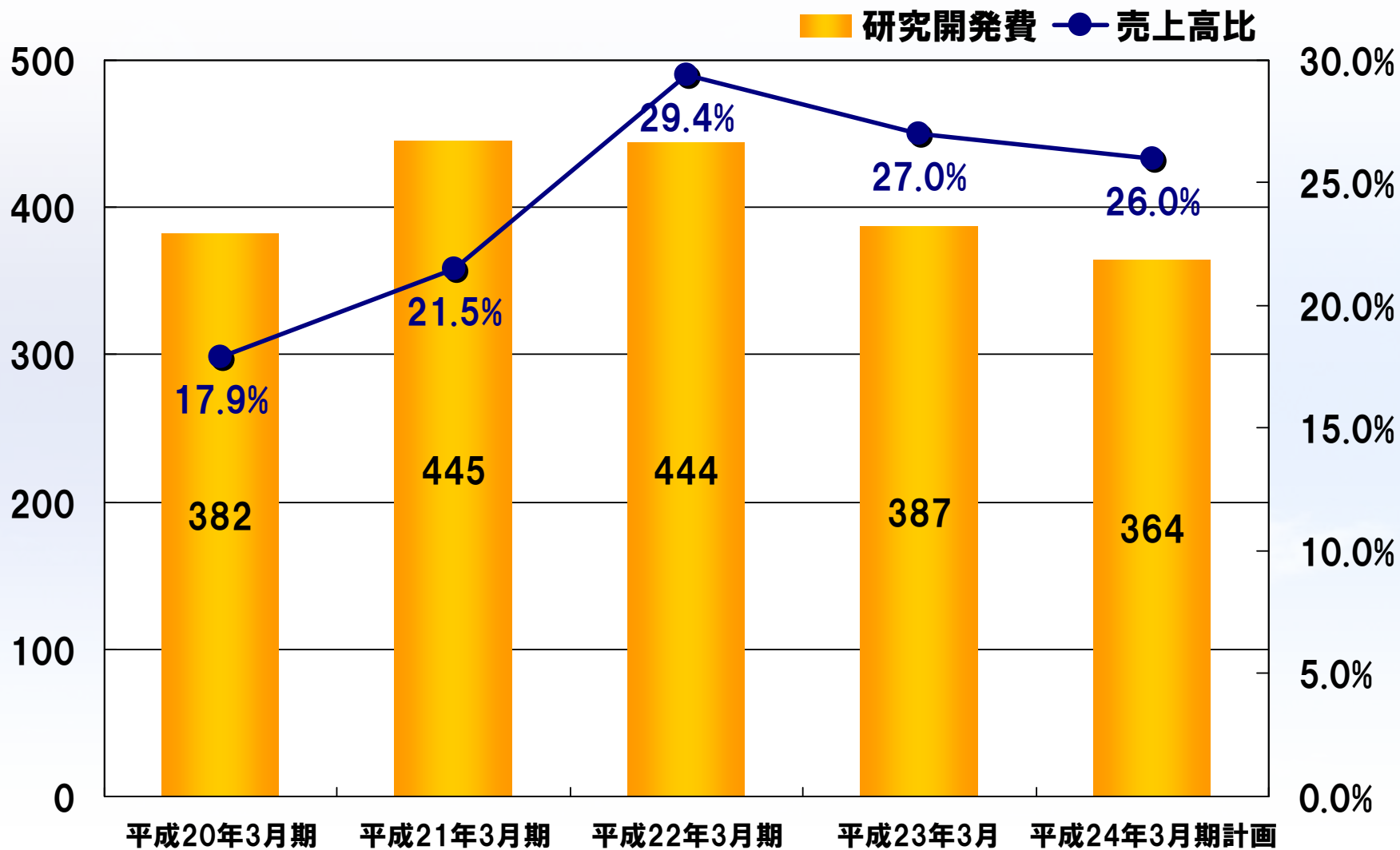
■ 人件費 ■ 外注費 (単位:百万円)
■ 減価償却・のれん償却費 ■ その他経費



国内経費減
 研究開発費減
 中国直販経費増



(単位：百万円)



ご清聴ありがとうございました